

2013年11月吉日

セミコン・ジャパン 2013 出展のご案内

2013年12月4日(水)～6日(金)の3日間に渡り、幕張メッセにおきまして、半導体製造装置・材料の国際展示会であるセミコン・ジャパン 2013 が開催されます。

当社は、「SAMURAI CSP Provider」として WLP、ウエハテスト、ファイナルテスト、テープ&リールを一貫して提供するターンキーサービスについてご紹介いたします。

是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。

■ 開催概要

1. 期間 2013年12月4日(水)～6日(金)
2. 場所 幕張メッセ
3. ブース 展示会場ホール1 V1-205

■ 参加セミナー、イベント概要

1. 出展者セミナー

<http://www.semiconjapan.org/ja/sessions/exhibitor-seminars>

開催日 2013年12月4日(水)
場所 Tech STAGE WEST (展示会場ホール1)
時間 15:00-15:20
内容 WLPの適用領域拡大に向けたパッケージ実装構造の最適化、
ならびに新技術開発
講演者 アドバンスドパッケージ開発部門 部門長
金子 紀彦

2. STS セッション4 テスト

<http://www.semiconjapan.org/ja/sessions/sts/Sess4>

開催日 2013年12月5日(木)
場所 国際会議場 3F 301 会議室
時間 12:10-12:35
内容 KGD モバイル用メモリの高速テスト保証
講演者 メモリビジネスユニット テストエンジニアリングサポート部門 部門長
川真田 陽介

3. OSAT エグゼクティブフォーラム

<http://www.semiconjapan.org/ja/sessions/STheater6>

開催日 2013年12月5日(木)

場所 国際会議場 2F コンベンションホール A

時間 16:20-17:00

内容 SAMURAI CSP Provider

講演者 グローバルセールス & マーケティングオフィス 執行役員
チーフセールスオフィサー& チーフマーケティングオフィサー
柴田 洋孝

4. 中古半導体製造装置セミナー

<http://www.semiconjapan.org/ja/sessions/used>

開催日 2013年12月6日(金)

場所 国際展示場 ホール 1

時間 11:00-11:35

内容 半導体後工程会社の中古装置活用

講演者 購買・情報システム部門 部門長
椋田 和雄

5. ハッピーアワー

開催日 2013年12月5日(木)

場所 展示会場ホール 1 V1-205

時間 16:00-17:00

● 本件に関するお問い合わせ先

sales@teraprobe.com

電話: 045-476-1002